

中国研究生创“芯”大赛



“华为杯”

各研究生培养单位
为进一步服务集成电路领域优秀人才
“赛”工作安排，
生创“芯”大赛

一、大赛背景

中国研究生
等院校及科研院所
实践活动。大赛
台，进行良好创
和实践探索的宝
大赛每年举
集成电路相关专
新人才成长、逐
各部门、高等院
和高度重视。

2021年，大
方为北京中关村

还将举办集成电路产业招聘会，以及第五产业论坛，邀请来自学界及业界嘉宾分享届芯动北京中关村 IC 产学研融合，拓宽参赛学生的视野。经验，促进集成电路

二、组织架构

指导单位：教育部学位管理与研究生

教育部学位与研究生教育教育司

主办单位：中国学位与研究生教育学发展中心

中国科协青少年科技中心会

协办单位：中国半导体行业协会

全国工程专业学位研究生

中国电子学会

教育指导委员会

示范性微电子学院产学融

清华校友总会集成电路专合发展联盟

清华海峡研究院

业委员会

承办单位：北京中关村集成电路设计

冠名赞助：华为技术有限公司

园发展有限责任公司

秘书处：清华海峡研究院

三、时间及地点

报名启动时间：2021年4月15日

报名截止时间：2021年6月27日

初赛作品提交截止时间：2021年6月

决赛时间：2021年8月17日至19日29日

决赛地点：北京中关村集成电路设计

司 (IC park)

秘书处 联系人：张逸轩
联系电话：0592-5776165；17606905288
邮件地址：cpicic@163.com
单位：清华海峡研究院
承办单位 联系人：李逸舟
联系电话：16601110821
邮件地址：liyzh@zgcicpark.com.cn
单位：北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司

中国研究生创“芯”大赛组委会
清华海峡研究院（厦门）代章

2021年4月9日